****

*
Server-on-Module: The new module with Intel® Iris™ Pro graphics offers three times more parallel execution power than the Skylake architecture without Iris graphics.*

*Text and photograph available at: http://www.congatec.com/press*

**Press release**

**congatec triple les performances graphiques de ses server-on-modules**

*Le nouveau module COM Express de congatec équipé des processeurs Intel Xeon et Intel Iris Pro.*

Paris -- 23 février 2016 -- congatec, acteur de premier plan dans le domaine des modules processeurs embarqués, des cartes SBC et des services EDM a ajouté à son catalogue de server-on-module COM Express Basic une version graphique puissante. Ce nouveau module comprend le processeur Intel® Xeon® E3-1515M v5, de la mémoire DDR4 rapide et Intel® Iris Pro graphics. Le GPU de ce nouveau module SoC fournit 128 Mo de eDRAM et avec ses 72 unités d'exécution, il dispose de trois fois plus de puissance d'exécution en parallèle que l'architecture Skylake sans graphique Iris. Les développeurs de systèmes COM Express très compacts ont désormais accès à de nouveaux niveaux de performances qui auraient nécessité une unité graphique dédiée.

Grâce à ses performances remarquables, le nouveau computer-on-module conga-TS170 rencontrera du succès auprès des applications de traitement d'image hautes performances des secteurs industriel et médical ainsi que les serveurs de gateways IoT industriels et les serveurs média avec virtualisation. Par exemple, le transcodage vidéo GPGPU, l'inspection complète des paquets ou l'analytique du big data. Plusieurs domaines d'application sont : les serveurs client léger industriels avec infrastructure de bureau virtuel (VDI). Pour administrer ces applications IoT, M2M et Industry 4.0 partagées, le nouveau module conga-TS170 propose aussi des outils pour serveur puissants. Grâce à la technologie Intel vPro et le contrôleur de gestion de la carte avec watchdog timer et contrôle de perte de puissance, le module est entièrement équipé pour une surveillance à distance, des tâches d'administration et de maintenance, voire la gestion hors bande.

**Les fonctionnalités en détail**

Le module conga-TS170 est équipé du nouveau processeur Intel Xeon E3-1515M v5 en 14 nm et du chipset Mobile Intel CM236. Il prend en charge jusqu'à 32 Go de mémoire SO-DIMM DDR4-2133 super rapide avec ECC pour les applications de serveurs de données sensibles. Le graphique intégré Intel Gen9 Iris Pro possède 72 unités d'exécution avec une fréquence d'horloge maximale de 1150 MHz. Pour des tâches de calcul en parallèle, il prend en charge OpenCL 2.0 et DirectX 12 ainsi qu'Open GL 4.4 pour des graphiques 3D de hautes performances sur 3 écrans 4k indépendants (3840 x 2160) via HDMI 1.4 et DisplayPort 1.2. Pour des applications standards, une sortie LVDS double canal et VGA sont disponibles. Le codage et encodage accéléré par hardware des vidéos HEVC, VP8, VP9 et VDENC sont aussi pris en charge.

En plus de PCI Express Gen 3.0 Graphics (PEG), le choix des interfaces d'E/S est le suivant : 8 voies PCI Express Gen 3.0, 4 USB 3.0, 8 USB 2.0, LPC et I2C. Le SSD et les autres stockages de masse non volatiles peuvent être connectés via 4 SATA 3.0 y compris le support RAID 0, 1, 5, 10. Tous les systèmes d'exploitation Linux et Microsoft Windows sont pris en charge y compris Windows 10. Un jeu complet de composants complémentaires pour faciliter le design comme les solutions de refroidissement, les cartes porteuses et les kits de démarrage, complète cette offre.

Une data sheet ainsi que des informations complémentaires sur le nouveau computer-on-module conga-TS170 sont disponibles sur :

 <http://www.congatec.com/en/products/com-express-type6/conga-ts170.html>

**A propos de Congatec**

Congatec AG, dont le siège est situé à Deggendorf, Allemagne, est un fournisseur de premier plan de modules processeurs industriels utilisant les standards Qseven, COM Express, XTX et ETX, de cartes SBC et de services EDM. Les produits de Congatec peuvent entrer dans un grand nombre d'industries et d'applications comme l'automatisation industrielle, les équipements médicaux, les loisirs, les transports, les télécoms, les tests et mesure et les points de vente. Parmi les compétences et le savoir-faire technique de Congatec, citons des fonctions BIOS uniques, des pilotes et des BSP (Board Support Packages) complets. Après la phase de design, les clients bénéficient d'un support tout au long du cycle de vie du produit. Les produits de Congatec sont fabriqués par des grands noms du monde de la sous-traitance électronique en respectant les standards de qualité. La société possède des filiales à Taiwan, au Japon, Chine, USA, Australie et République Tchèque. Site web : [www.congatec.com](file:///C%3A%5CUsers%5Cdesmaele%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5Cdesmaele%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5Cdesmaele%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.Outlook%5CA0UKGA4I%5Cwww.congatec.com) ou via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) and [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE)

\* \* \*

*Intel, Intel Iris, Intel vPro, and Intel Xeon are registered trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*